

附件二 高雄區農業改良場研究成果技術移轉意願書

廠商名稱	
移轉技術名稱	蓮霧截切加工技術
產學合作計畫名稱及編號	
計畫主持人	陳正敏
擬利用技術內容	<ol style="list-style-type: none">1. 蓮霧截切加工技術。2. 蓮霧截切加工產品銷售販賣授權。
預期應用範圍及預期產品	

申請人（公司代表人）：_____ (簽章)

附註日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日